

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于南京晶升装备股份有限公司**  
**2023 年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：晶升股份
保荐代表人姓名：姚黎	联系电话：025-83387749
保荐代表人姓名：范哲	联系电话：025-83387697

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对晶升股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

## 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1、技术研发风险

半导体材料技术指标由晶体生长设备技术能力及客户制造工艺技术能力共同实现，晶体生长设备技术能力对材料微缺陷水平、金属含量、氧含量等材料技术指标具有重要影响。

若在后续研发过程中，公司面临因产品技术及工艺无法持续升级，下游应用

领域拓展不及预期,研发资金投入过高,研发进度缓慢等情形引发技术研发风险,则可能导致公司技术研发及产业化应用失败,技术研发及创新无法满足下游行业实际应用需求,创新成果转化产品需求无法达到客户需求,已投入研发创新成本无法实现预期收益,产品市场竞争力下降等风险,进而对公司的经营规模、盈利能力等方面造成不利影响。

## 2、核心技术人员流失或短缺的风险

随着国内半导体设备行业持续快速发展,行业竞争日益激烈,专业技术人才的需求也将不断增加,若公司不能持续为技术人员提供良好的激励机制和发展平台,公司将面临核心技术人员流失或短缺的风险,从而对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

## (二) 经营风险

### 1、经营规模风险

未来期间,若公司新增投入研发、管理、销售等生产经营资源无法有效实现业务转化,投入成本效益不及预期,将对公司经营业绩带来持续不利影响。与此同时,公司生产经营面临下游产业、客户发展速度及产业化应用不及预期、行业竞争加剧及市场竞争力下降、技术研发及业务发展未达预期等诸多风险,均可能导致公司报告期后存在产品新增需求减少、收入规模下滑、产品毛利率波动、经营成本上升、经营业绩存在下滑及亏损的风险。

### 2、主要经营场所系租赁取得的风险

目前公司用于生产、研发的厂房及办公场所等房屋均为租赁取得。若出租方在租赁期满前提前终止租赁合同,或公司在租赁期满后不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地及厂房问题,将使公司及其子公司的生产场地面临被动搬迁的风险,从而对生产经营产生不利影响。

## (三) 财务风险

### 1、应收账款回收风险

随着公司营业收入规模的不断增长,如未来国内半导体产业发展速度放缓、

客户经营情况等发生重大不利变化，公司将面临应收账款回款周期延长、坏账增加等风险。

## 2、存货减值风险

报告期期末，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品等构成。公司主要采取订单式生产和库存式生产相结合的生产模式，根据客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造。期末存货余额主要为根据客户订单及发货需求形成的库存商品和尚未验收的发出商品，以及通过市场研判及客户沟通形成销售预测实施的生产备货。公司产品自原材料备货至交付验收存在一定的时间周期。未来，随着公司产销规模的持续扩大，若公司无法对存货进行有效管理，因产品技术更新迭代、销售预测变动、已签订合同订单变更或取消、产品验收无法通过、产品销售价格发生重大不利变化等因素而导致公司存货积压及价值减损，存货可变现净值低于账面净值，发生存货跌价风险，将对公司资产质量、经营业绩和盈利能力造成不利影响。

## 3、毛利率下降风险

公司产品毛利率变动主要受不同类别产品技术附加值及定制化需求差异、市场开拓及产品定价策略、市场竞争因素、主要零部件采购规模、价格变动等因素影响。若未来上述影响因素发生重大不利变化，公司毛利率将会面临下降的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。

## 4、经营活动现金流量净额下降的风险

公司目前处于业务快速增长期，因履行新增业务投入采购、生产的营运资金呈持续增长趋势，导致公司各期经营活动现金流量净额与净利润增长趋势不完全同步。未来随着公司经营规模的持续扩大，购建长期资产及营运资金需求日益增加，如果客户不能及时履行产品结算义务，或公司资金周转及使用效率降低，可能导致公司出现流动性风险。

## 5、政府补助与税收优惠政策变动的风险

公司自成立以来，凭借多项科技成果研发转化、高端装备研制等项目收到政府补助及相关科技奖励。如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降

低，将会对公司经营业绩产生不利影响。

公司被认定为高新技术企业，报告期内公司享受高新技术企业所得税的优惠税率。如果未来公司无法通过高新技术企业资格复审，或国家相关税收政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而对公司经营业绩造成不利影响。

## **（五）行业风险**

### **1、市场竞争风险**

伴随着中国半导体终端应用市场的不断增长，全球半导体产业第三次转移的进程，中国半导体设备、材料、制造、封测等子行业的发展迅速，占全球半导体市场份额将逐步提升。一方面，国际主要半导体材料及专用设备厂商将凭借其现有的资金、技术、市场及客户优势，在国内半导体市场进一步巩固及扩大其市场份额及领先优势；另一方面，随着我国政策的大力支持，国内新增半导体材料设备厂商也逐渐加入行业参与竞争。若公司未来无法有效应对国际主要厂商和国内新进入者的双重竞争，公司的财务状况及经营成果都将受到不利影响。

## **（六）宏观环境风险**

### **1、宏观经济波动及产业政策变化风险**

半导体行业发展呈现一定的周期性特点，如果未来宏观经济增速下滑，终端消费市场的需求下滑，上游产业链资本性投入及产出大于行业应用需求，产能利用率下降，半导体材料及芯片制造厂商将减少半导体设备的采购，宏观经济及行业固有的周期性波动将对公司发展产生不利影响。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，因技术发展等因素导致产业国产化进程减速或不及预期，公司亦将面临因产业政策变化导致经营业绩下滑的风险。

## **（七）法律风险**

### **1、知识产权争议风险**

半导体专用设备行业是典型的技术密集型行业，公司存在与竞争对手产生知识产权纠纷的风险，届时可能需要通过法律诉讼等方式维护自身权益，由此可能需承担较高的法律和经济成本，将对公司的生产经营造成不利影响。

## 2、诉讼或其他法律纠纷风险

截至本报告披露日，公司存在银行账户（非主要经营账户）被南京市栖霞区人民法院冻结的情况，冻结涉及的银行账号为：0156240000002360、0156220000002361、0156200000002362；账户类型：3年期大额存单；合计金额：3,000.00万元；冻结时效：1年。

上述冻结事项系由中科钢研节能科技有限公司因设备买卖合同纠纷案件一审诉讼请求被南京市栖霞区人民法院驳回后提起上诉而申请。

截至本报告出具日，南京市中级人民法院已受理该上诉案件。最终结果尚存在不确定性，对公司造成的实际影响最终需以法院判决结果为准。

## 三、重大违规事项

2023年度，公司不存在重大违规事项。

## 四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度，公司主要会计数据如下：

单位：万元

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	40,557.08	22,199.29	82.70
归属于上市公司股东的净利润	7,101.75	3,453.60	105.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,239.10	2,271.22	86.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,168.98	1,848.42	-596.04
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	158,299.23	52,061.66	204.06
总资产	210,985.70	61,040.26	245.65

2023年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.56	0.33	69.70
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.33	69.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00
加权平均净资产收益率(%)	5.77	6.91	减少1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.55	减少1.11个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.37	9.35	增加0.02个百分点

上述主要会计数据及财务指标的变动原因如下：

1、2023年实现营业收入较上年同期增长82.70%，主要系销售规模扩大，批量订单在本期验收量增加所致。

2、2023年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长105.63%，主要系销售收入增长、经营效率提升、成本费用的合理管控以及理财收益等其他收益增加所致。

3、2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长86.64%，主要系销售收入增长与降本增效所致。

4、2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少596.04%，主要系订单增加带来的采购付款增加，支付的职工薪酬增加，支付的税费增加，以及经营规模扩大增加的其他费用支出和投标保证金支出增加所致。

5、2023年基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长69.70%，主要系本期净利润增加所致。

6、2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长204.06%，主要系本期募集资金到账增加股本和资本公积、本期净利润及法定盈余公积增加所致。

7、2023年末总资产较上年末增长245.65%，主要系本期销售相关应收票据和应收账款增加、未验收产品的存货增加、募投项目相关的在建工程 and 无形资产增加、理财产品增加所致。

## 五、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力情况如下：

### 1、公司具有先发优势

半导体材料及专用设备行业具有技术壁垒高、研发周期长、资金投入大、下游验证周期长等特点。基于上述特点，目前，国内晶体生长设备领域仅有公司及其他少数行业参与者可实现设备技术验证并批量供应晶体生长设备。此外，考虑到半导体产业链各环节的技术要求、精密程度及稳定性要求极高，通常来说，下游芯片厂商对已通过认证的半导体设备及制备工艺均会进行稽核，硅片/衬底材料厂商对半导体设备和制备工艺的改动均需通知下游芯片厂商，待其进行审核后方可进行。由于更换半导体设备供应商需要较长的时间进行上述稽核，且存在较大的不确定性，已通过认证的半导体设备供应商可形成较强的客户认证壁垒。由于晶体生长设备对硅片/衬底的规格指标及性能优劣具有重要影响，进而对芯片制造及半导体器件的成本与性能产生重要影响，故是否已在下游客户产线投入使用并形成较强的客户认证壁垒，成为衡量晶体生长设备供应商市场竞争力的重要标准。公司无论在大尺寸半导体级单晶炉，还是碳化硅单晶炉方面都具有先发及客户认证的优势。

### 2、公司具有技术及研发优势

公司基于在晶体生长设备行业多年积累的专业技术及工艺，通过持续研发，对工艺技术和设备不断优化升级，同时对标国外晶体生长设备前沿技术的发展方向，在晶体生长设备设计、晶体生长工艺及控制等技术方面，形成了独创性的设计及技术，掌握了晶体生长设备设计及控制技术、热场的设计与模拟技术和半导体晶体生长工艺开发技术等核心技术，并成功应用到公司主要产品中且实现量产销售，产品技术水平国内领先，部分技术指标已达到国际主流先进水平。公司凭借自主研发的晶体生长设备技术，以及多应用领域产品技术开发经验，已在半导体级晶体生长设备领域形成丰富产品序列，可满足不同客户差异化、定制化的晶体生长制造工艺需求。同时，公司提供的晶体生长设备已在下游客户产线批量投入使用，得到了众多客户的认可。公司持续对晶体生长设备进行研发，积累了大量的研发经验和技術储备，有助于公司进一步提升技术水平优势和竞争优势。

### 3、公司具有优质客户资源优势

晶体生长设备作为半导体产业链的基础和起点，其设备供应商的市场竞争力主要体现于设备的研发设计、晶体生长工艺积累及下游厂商的认可程度，市场竞争结果体现为设备供应商所开拓客户的实力及地位、是否获得重复和批量订单、设备是否已投入产线使用及市场份额等。

公司凭借多年的研发及工艺积累，结合“晶体生长设备—工艺技术—晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，形成了自主研发的核心技术，并覆盖了硅片厂商及碳化硅衬底的国内龙头企业或主流客户，与沪硅产业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）、神工股份、合晶科技、三安光电、东尼电子、比亚迪等知名企业建立了合作关系。自签订首台（套）合同后，公司得到了客户的认可并获得客户的重复和批量订单，结合客户产线建设及业务开展情况，持续推进批量销售且保持跟进，形成了相对其他晶体生长设备企业较强的客户资源优势。此外，通过与上述半导体制造企业建立合作关系后，对客户的核心需求、技术发展的趋势等方面理解更为深刻，有助于公司在研发方向的选择及增强客户粘性，保证了公司未来收入的持续、稳定增长及业务的进一步拓展。

#### 4、优秀的技术研发团队是保证公司竞争优势的驱动力

公司高度重视技术研发团队建设和培养，持续引进行业内的专业人才，经过多年的积累，公司形成了一支经验较为丰富，技术水平较高的技术研发团队，能紧密跟踪国内外先进技术发展趋势，保证了公司能够不断推出新产品，并不断改进现有产品，巩固和提升公司的技术研发能力。公司按照半导体级单晶硅炉和化合物单晶炉设备等不同研发对象和项目产品，组成了分工明确的专业研发团队。在核心技术人员带领下，公司在晶体生长设备领域不断突破。

#### 5、定制化服务及区位优势巩固与客户的关系

半导体制造企业具有高度定制化的需求，故供应商服务的快速响应和熟悉客户相关工艺的经验能力尤为关键，保证了双方无障碍沟通。随着半导体制造环节向亚洲尤其是中国大陆转移，相较于国际竞争对手，在服务中国大陆半导体制造企业方面，公司在地域上更接近客户，对客户的需求及问题能够提供更快捷、更经济、更顺畅的技术支持和客户维护。此外，公司销售及研发人员会定期进行客户拜访，以了解客户需求及市场发展趋势，并对公司产品进行升级或更新换代，

以保持产品的持续竞争力。

#### 6、运营成本优势

针对海外竞争对手，由于其研发和生产人员成本较高，并且基于距离、沟通不便等因素，服务中国大陆客户的成本较高。公司的研发和生产主要位于中国大陆，拥有区位优势，人员成本相对较低。此外，公司与国内外供应商建立了较为稳定合作关系，具有较为完善的原材料供应链体系，有利于保证公司产品原材料来源的稳定性及可靠性。同时，随着本土供应链的不断成熟，给予了公司更多的采购选择，使得原材料采购更为稳定，有效降低了公司原材料采购成本及运营成本。

2023年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

## 六、研发支出变化及研发进展

2023年度，公司研发投入3,801.50万元，较上年同期增加83.10%。截至2023年12月31日，公司累计取得国内专利87项，其中发明专利34项，实用新型专利53项。此外，公司拥有计算机软件著作权4项。报告期内，公司获得新增授权专利12项。

## 七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 八、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资

金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币84,803,487.56元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,124,916,360.48
减：直接使用募集资金支付的发行费用	103,642,893.05
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额	4,715,408.53
减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额	40,159,385.92
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	40,711,647.68
减：闲置募集资金进行现金管理余额	699,800,000.00
减：银行手续费	576.00
减：永久补充流动资金	160,000,000.00
加：利息收入	2,415,840.93
加：闲置募集资金现金管理收益	6,501,197.33
截至2023年12月31日募集资金余额	84,803,487.56

截至2023年12月末，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构提示及建议公司严格按照上述法律法规的相关要求使用募集资金，关注募投项目进展情况，并采取积极有效措施，持续推动募投项目建设。

## 九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司上市以来，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股数未发生变动。

截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

## **十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京晶升装备股份有限公司  
2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： 姚黎  
姚黎

范哲  
范哲

